

## RFスパッタ装置 SP-1500R



成膜室は小型ですが、基材加熱温度も高く、RFモードのスパッタリングが出来ますので、基材の大きさが3インチ以下であれば、高度な成膜実験が出来ます。圧力調整弁は手動式ですが、マスフローコントローラによるガス流量調整によって、高精度圧力調整が出来ます。

### RFスパッタ装置SP-1500R仕様

○到達圧力	×10 <sup>-4</sup> Pa台※常温・無負荷・脱ガス時
○排気速度	×10 <sup>-4</sup> Pa台迄20分以内※常温・無負荷・脱ガス時
○成膜室径	φ300mm×250mmH SUS304 電解研磨
○スパッタ用電源	RF電源 13.56MHz 500W 手動マッチング 1台
○基板形状	φ50mm 1枚
○膜厚分布	±15%以内
○ターゲット寸法	3インチ(金属・絶縁物)
○ターゲット個数	1
○基板回転	有り
○基板加熱	常温～500℃迄昇温可能
○真空排気系	油回転ポンプ:350L/min 油拡散ポンプ:600L/sec
○操作方法	手動
○ガス系統	マスフローコントローラ 1系統
○ユーティリティ	電気:AC200V三相7KVA 冷却水:7L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア:0.5MPa以上 設置寸法:1200mmW×1000mmD×1600mmH